

无硅导热膏

导热膏与导热片相比可变得更薄,实现极低的热阻。

具有良好的操作性,能够轻松分配或涂布到基板上。

另外,由于未使用硅油,不会发生由低分子量硅氧烷导致的接点故障等问题。

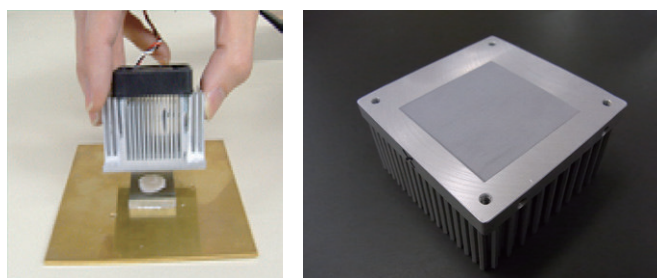
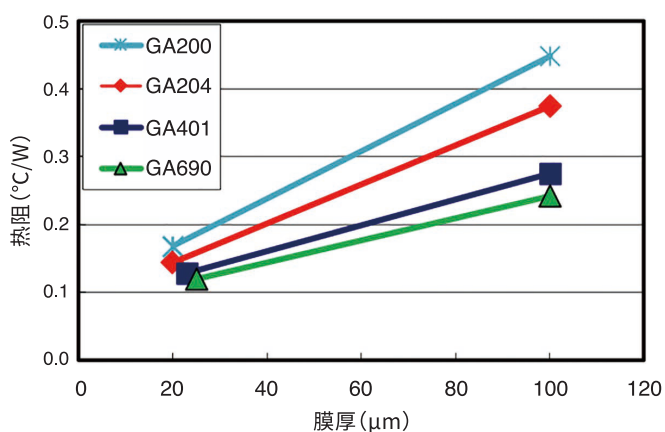


各种特性

项目	单位	品名	GA200	GA204	GA401	GA690
热传导率*1	W/(m·K)		2.0	2.4	4.1	4.5
外观	—		白色	白色	灰色	灰色
基础材料	—		酯类油	酯类油	酯类油	酯类油
粘度	Pa·s		170	110	350	300
最小膜厚	μm		20	20	25	25
热阻值	°C/W		0.17	0.14	0.13	0.13
溶剂	—		无	无	无	含有
使用温度范围	°C		-40 ~ 150	-40 ~ 150	-40 ~ 150	-40 ~ 150
供货形式	—		储罐或注射器	储罐或注射器	储罐或注射器	储罐

※1 热丝法

热阻比较



涂布示意图: 左; 分配、右; 印刷



供货形式: 左; 注射器、右; 储罐

热阻测量条件 使用本公司制造的热阻测量装置,样品尺寸 10mm×10mm,加热器热量 25W

※图、表中的测定值为实测值,并非产品标准值。